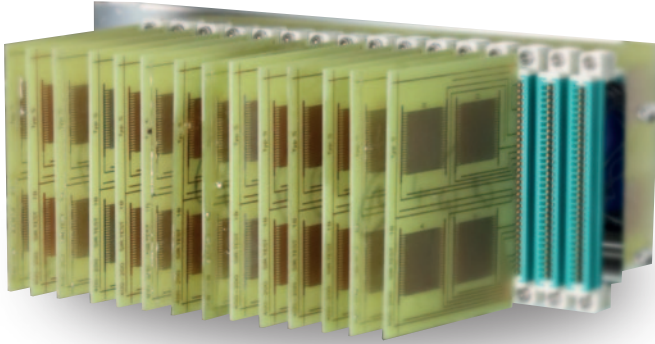


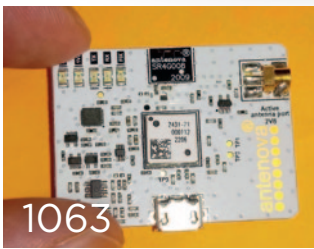
INHALT

August 2022



1117

Um die elektrische Sicherheit von Flussmitteln in der Löttechnik zu ermitteln, muss der Oberflächen-Isolationswiderstand (Surface Insulation Resistance, SIR) gemessen werden. Dies geschieht mithilfe der so genannten SIR-Tests



1063

GNSS-Empfängermodul mit stark reduziertem Stromverbrauch



1065

Neues Debugging-Tool für RISC-V-Prozessor des FhG-IPMS verfügbar



1083

Input für Insider: 17. BayernInnovativ-Kooperationsforum Leiterplattentechnologie

EDITORIAL

„Wie werden die Leser der PLUS auf mich reagieren?“ 1041

AKTUELLES

NEWS & Trends 1045
TERMINE & Events 1060

BAUELEMENTE

GNSS-Empfängermodul mit fünffacher Laufzeitreserve 1063

DESIGN

Weiteres De-Bugging-Tool für RISC-V-Core verfügbar 1065

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H. J. Friedrichkeit):
Das Rolex Prinzip - Warum die neue Mercedes Luxus- Strategie erfolgreich sein könnte 1073
Leiterplatte auf dem Weg zum All-in-One Package 1083

BAUGRUPPEN & SYSTEME

Zukunft der High-Performance-Mechatronik 1097
EBL 2022: Intelligente Prozesskette 1102

ANALYTIK & TEST

SIR-Tests: Sicherheit und Qualität nach strengster Norm 1117

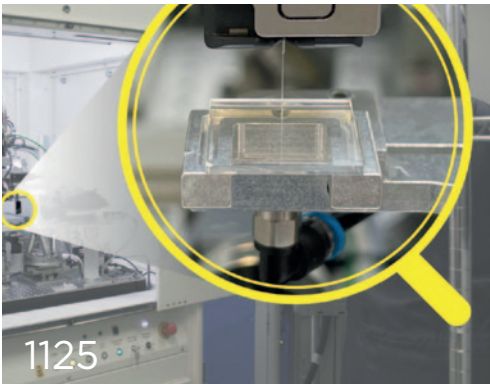
Qualitativ hochwertige Basismaterialien und Prepregs

Flexible, zuverlässige Supply-Chain-Lösungen



1102

EBL 2022: Nachholtermin in der Fellbacher Schwabenlandhalle mit geballtem Wissen rund um Digitalisierung und Datenströme



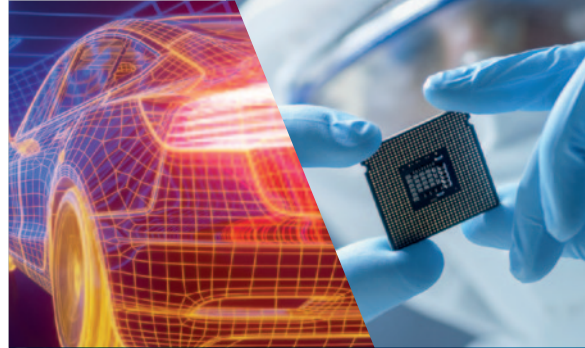
1125

AVT-Strategien für photonisch integrierte Schaltkreise (PICs) setzen bislang auf Kleben. Ein neues IZM-Verfahren setzt stattdessen auf Lasern

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Klebstofffreie Faser-zu-Chip-Anbindung für integrierte Photonik

1125



Ventec International Group

Ventec ist Spezialist für die Herstellung von hochwertigen Basismaterialien und Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz liefert kundenspezifische Supply-Chain-Lösungen in allen Regionen der Welt. Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren in China, Großbritannien, Deutschland und USA, ist niemand besser positioniert, um die Bedürfnisse der globalen Leiterplattenindustrie zu bedienen.





Künftige KI-Anwendungsfelder liegen beispielsweise in der Medizin: Ein Beitrag über KI-Vordenker Prof. Dr. Sebastian Thrun

FORUM

Kolumne: Kostelniks Platten-Tektonik	1129
Vordenker Thrun: Chancen Künstlicher Intelligenz größer als ihre Risiken	1132
Kolumne: Heile, heile Gänseje...	1134
PLUS-Firmenverzeichnis	1138
Im Heft redaktionell erwähnte Firmen	1164
Inserentenindex	1165
Mediadaten	1166
Impressum	1167
Produkt des Monats	1168

Titelbild

Ein Name. Ein Anspruch. Becker & Müller steht für Leiterplatten – High Quality, High Speed und High Flexibility. Seit 37 Jahren spezialisieren wir uns auf den Bereich Prototyping sowie Kleinserien & Muster. Profitieren Sie von unserem Know-How, unserem stets modernen Maschinen- und Anlagenpark und unserem qualifizierten Team. Die gemeinsame Entwicklung zusammen mit unseren Kunden und deren Anforderungen sind unsere Innovationstreiber und Optimierer. Das und eine reine Eigenfertigung sind die Basis von Qualität und Präzision – Made in Germany.

Der schnellste Weg zur perfekten Leiterplatte geht über unseren PCB EXPRESS-SERVICE. Wir freuen uns auf Sie!

Tel.: +49 (0)7832 9180-0
 Mail: brief@becker-mueller.de
 Web: www.becker-mueller.de

Die Fachzeitschrift PLUS enthält exklusive Mitglieder-Informationen folgender Fachverbände:



Fachverband Elektronik-Design e. V.
 Tel. +49 30 340 60 30 50
info@fed.de, www.fed.de

1067



EIPC – Der Europäische
 Elektronik-Verband
 Tel. +31 46 4264258
www.eipc.org

1078



Fachverband Electronic
 Components and Systems
 Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

1089



Fachverband PCB
 and Electronic Systems
 Tel. +49 69 6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL
 MICROELECTRONICS
 AND PACKAGING SOCIETY –
 Deutschland e. V.
 Tel. +49 3677 69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de

1111



Forschungsvereinigung
 Räumliche Elektronische
 Baugruppen 3-D MID e. V.
 Tel. +49 911 5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de

1120



DVS – Deutscher Verband
 für Schweißen und
 verwandte Verfahren e. V.
 Tel. +49 211 1591-0
romina.krieg@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

1128